

深圳市联得自动化装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>券商策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券、博时基金、朴拙资本、中财招商投资、沁闻投资共 5 人
时间	2026 年 9 月 9 日
地点	券商策略会现场（深圳）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司主要竞争优势是什么？ A1：公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、哈曼、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。

Q2：公司在半导体先进封装领域有哪些布局？

A2：公司积极布局半导体封测设备业务，已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。主要产品包括高精度显示芯片倒装键合机、高速共晶固晶机、软焊料固晶机、AOI 检测、引线框架贴膜和检测设备。在先进封装领域，公司有针对性显示驱动芯片键合设备（ILB 设备），该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。目前公司半导体设备主要面向国内集成电路、分立器件封测及半导体封装材料领域企业，已与华天科技、厦门通富、安世半导体等企业建立初步合作关系，相关业务尚处于起步阶段，现阶段业务规模较小。

Q3：公司的产品和技术是否可以应用到手机折叠屏？

A3：公司柔性 AMOLED 贴合类设备已应用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系，持续跟进柔性显示新技术迭代开展技术协同。在折叠屏领域，公司具备深厚的技术储备与成熟量产经验，折叠屏 UTG 超薄柔性玻璃贴附类设备已向行业头部客户实现批量出货，该业务是公司重要的业务方向，有助于公司巩固行业竞争地位，培育新的盈利增长点。

Q4：公司在固态电池及新能源其他业务方面有哪些布局？

A4：在新能源设备领域，公司已形成覆盖锂电池包蓝膜、固态/半固态电池超声焊接、切叠一体机、电芯装配及 Pack 段整线自动化设备产品矩阵。同时，公司积极布局钙钛矿相关工艺设备的研发，在 GW 级涂布设备、VCD 设备和 HP 设备领域取得关键突破，相关设备已在客户端中试线开展验证运行。后续公司将继续推进新能源设备自动化、一体化、智能化方向研发迭代，持续打磨产品，提升产品竞争力，深化与下游客户的合作。

Q5：公司研发的高精度芯片键合设备可应用于哪些方面？

A5：公司自主研发的全自动高精度芯片键合设备，面向 COC、COS 共晶工艺开发，标准片键合精度可达 $\pm 1 \mu m$ ，集成共晶、银胶双工艺，支持蘸胶、点胶多种作业模式。同一设备可完成两类工艺加工，无需配置两套独立产线，能够帮助客户节约设备投入、提升产品切换效率，可适配光通信、激光雷达、传感器等高精度封装应用场景。

	Q6: 请介绍一下公司今年上半年的研发投入情况以及未来的研发投入重点是什么? A6: 公司的研发投入总额为 5,224.98 万元, 占营业收入 8.92%。未来公司将持续保持研发投入力度, 重点布局光通讯用 COC/COS 设备, 板级封装涂布、ABF 层压、HVCD、热板、贴膜、键合设备等方向, 持续强化技术创新能力, 把握产业发展机遇, 提升公司在光通讯、板级封测领域的综合竞争优势。 Q7: 公司未来如何继续拓宽销售渠道? A7: 公司持续推动全球化业务的布局工作, 在稳定国内市场领先优势及市场份额的前提下, 积极开拓海外销售市场。公司凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系, 获得了海外大客户的广泛认可, 并达成了深度合作。未来公司将持续开拓海外销售市场, 进一步拓宽销售渠道, 不断推进公司业务发展, 以良好的经营业绩回报广大投资者。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-9-9